

日月光一〇一年度第三季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 101 年 10 月 26 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇一年度第三季獲利報告，本公司一〇一年第三季之合併營業收入較一〇一年第二季成長 7%，較一〇〇年同期成長 5%，為新台幣 48,991 百萬元。茲將日月光一〇一年度第三季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	101 年度 第三季	101 年度 第二季	100 年度 第三季	101 年度 前三季	100 年度 前三季
營業收入	48,991	45,872	46,698	137,964	138,957
營業毛利	9,604	8,857	8,912	25,650	26,534
營業淨利(淨損)	4,798	4,174	4,312	11,818	13,320
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,458	3,738	4,200	10,780	14,045
所得稅利益(費用)	(865)	(442)	(717)	(1,772)	(2,678)
少數股權純損(益)	(147)	(94)	(15)	(303)	(281)
本期淨利(淨損)	3,446	3,202	3,468	8,705	11,086
稀釋每股盈餘(元)	0.45	0.42	0.45	1.14	1.43

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	101 年度 第三季	101 年度 第二季	100 年度 第三季	101 年度 前三季	100 年度 前三季
營業收入	33,891	32,485	32,581	95,613	95,715
營業毛利	7,726	7,288	7,319	20,670	21,948
營業淨利(淨損)	4,016	3,697	3,866	10,137	12,172
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	4,199	3,539	4,004	10,161	13,360
所得稅利益(費用)	(704)	(310)	(523)	(1,369)	(2,001)
少數股權純損(益)	(49)	(27)	(13)	(87)	(273)
本期淨利(淨損)	3,446	3,202	3,468	8,705	11,086
稀釋每股盈餘(元)	0.45	0.42	0.45	1.14	1.43

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	50
個人電腦	12
汽車及消費性電子產品	37
其他	1
前十大客戶佔營收比重	48

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	55
歐洲	12
台灣	21
日本	6
亞洲其他地區	6

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced Packaging	22
IC Wirebonding	68
Discrete and Others	10
封裝資本支出金額	229 百萬美元
打線機台數	15,612 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	80
晶圓測試	18
前段測試	2
測試資本支出金額	92 百萬美元
測試機台數	2,809 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	30
電腦產品	26
消費產品	16
工業產品	18
汽車電子產品	8
其他	2
前十大客戶佔營收比重	79
EMS 資本支出金額	14 百萬美元